

2008 年 4 月 28 日

報道各位

住友金属鉱山株式会社

当社事業部門の組織改正について

当社は、コアビジネスの一つである電子材料および機能性材料事業の一層の拡大強化を図るため、2008 年 10 月 1 日目途で当事業部門の組織を改正し、『半導体材料事業部』および『機能性材料事業部』に再編することといたします。

また、同時期に、エネルギー・環境事業部を新たに『エネルギー・触媒・建材事業部』としてスタートさせることといたします。

当社は、「2003 年中期経営計画」以降、本格的な成長に向けた戦略を推進してまいりました。このうち、資源・金属事業におきましては、10 年後の「非鉄メジャークラス入り」に向けた東予工場の銅生産量 45 万トン体制やコーラルベインニッケル社における HPAL プロジェクトの立上げ、さらにはポゴ金鉱山の開発などの戦略を着実に実行してきた結果、金属価格の高騰も加わり、計画以上の業績を挙げております。

一方、「商品ごとに世界トップクラスのシェアをめざす」ことで成長を狙っている電子・機能性材料事業におきましては、商品ごとに成長に向けた戦略を展開しておりますが、当社の強みである材料技術の総合力を強化することで飛躍的な成長を遂げるため、今回の組織改正を実行することといたします。

当社の電子・機能性材料事業は、現在、電子事業本部および機能性材料事業部ならびに関係会社である住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社グループで事業展開しておりますが、今回、これらの事業部門を『半導体材料事業部』および『機能性材料事業部』に再編し、コアビジネスの一つである電子・機能性材料事業において、全体最適の観点によるシナジー効果の最大化を狙うとともに、新商品開発のスピードを一層加速させることで、当社の強みである高度な材料技術に磨きをかけ、さらなる発展を図りたいと考えています。

例えば、半導体材料事業部では、二層めっき基板からチップオンフィルム（COF）テープまでの一貫した体制とすることで、材料技術の強みをより活かす運営を目指します。また、お客さまがほとんど一緒であるボンディングワイヤー事業とリードフレーム事業を一つの事業部に集約することで、よりきめの細かい顧客サービスを目指します。

機能性材料事業部では、ニッケル粉からニッケルペーストまでの一貫生産体制を確立するとともに、薄膜材料とインジウムの生産の一体化を促進いたします。

これらの事業部門の再編に加えて、研究開発体制の強化として、両事業部に『技術部』とその下部組織としての『開発センター』を新設し、お客さまからの要望や要請に即座に応え、さらなる技術力向上を目指す体制を構築するとともに、技術本部に『先端技術情報部』を新設し、新製品開発の体制強化とスピードアップを図ります。

また、両事業部のスタッフ機能を本社に集約させ、より適切かつタイムリーな意思決定ができる事業運営を行なってまいります。

このような今回の組織改正を一つの手段として、「2006 年中期経営計画」で掲げております、電子材料および機能性材料事業での営業利益 200 億円の達成に向けて邁進してまいります。

また、2000 年 4 月の「企業再生計画」以降進めてまいりました、事業の選択と集中につきましては、所期の目標をほぼ達成しましたので、コアビジネスである資源・金属事業および電子・機能性材料事業とは違う分野の事業および関係会社についても、成長の機会をうかがうべく、現在のエネルギー・環境事業部の事業範囲を拡大し、新たに触媒事業および建材事業を加え、『エネルギー・触媒・建材事業部』としてスタートすることといたします。

* HPAL：High Pressure Acid Leach（高圧硫酸浸出）

東予工場：愛媛県 西条市

コーラルベイニッケル社：フィリピン共和国

ポゴ金鉱山：米国アラスカ州

（本件に関するお問い合わせ先）

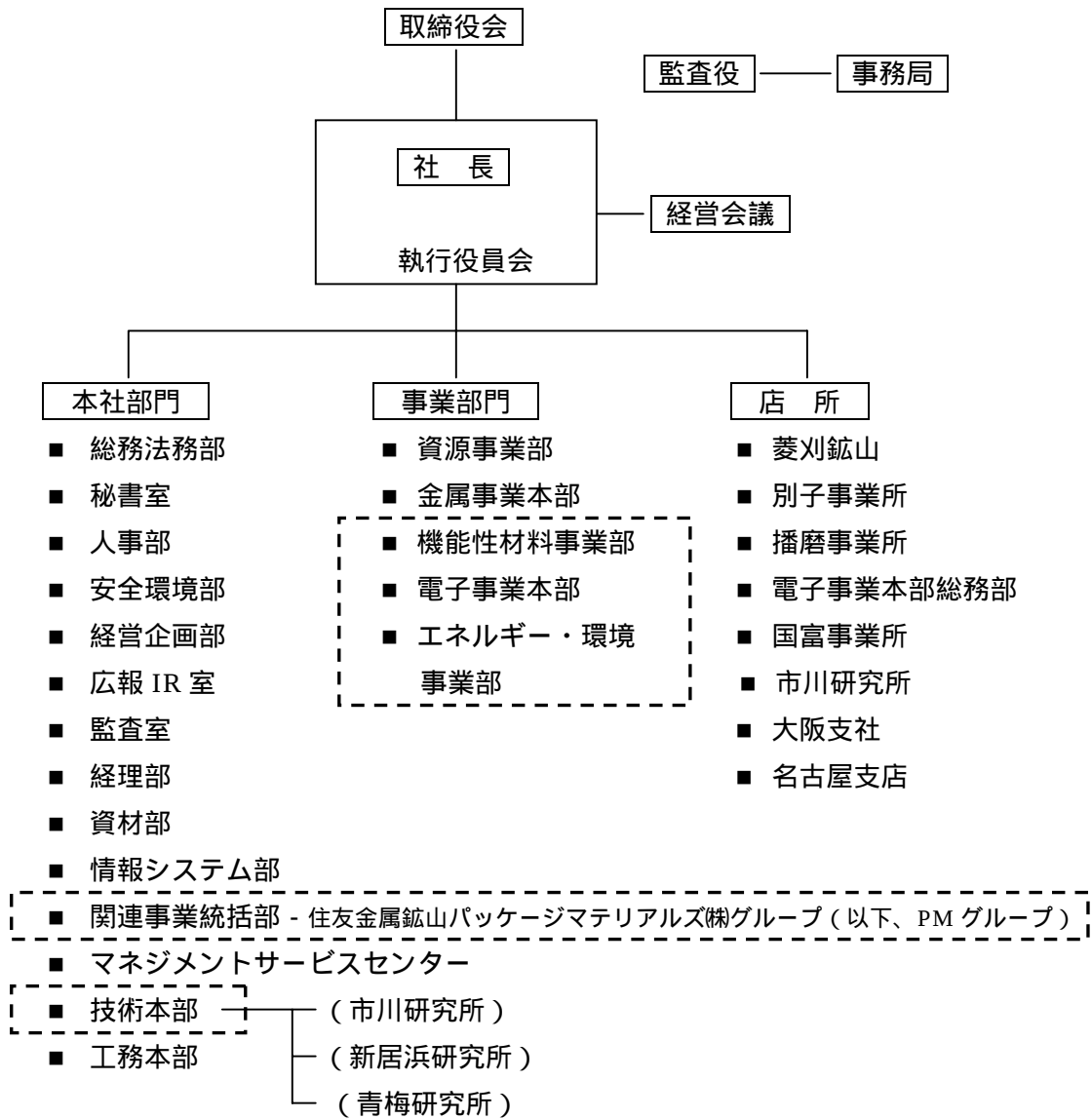
広報 IR 室 大場浩正

TEL：03-3436-7705

(ご参考)

1. 今回の組織改正の対象範囲について

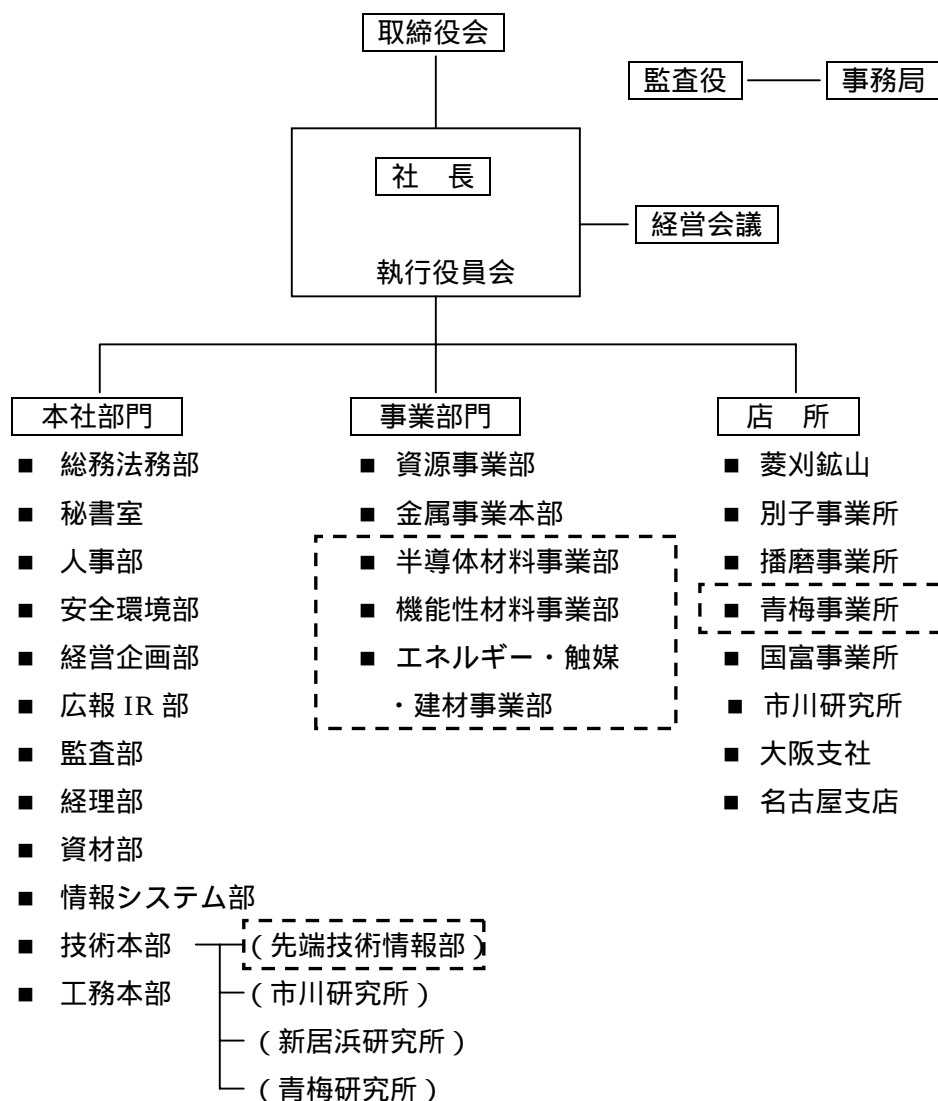
(2008年4月28日現在組織図)



----- 本件組織改正の対象範囲

2．当社の 2008 年 10 月 1 日以降の組織について

(2008 年 10 月 1 日以降の組織図)

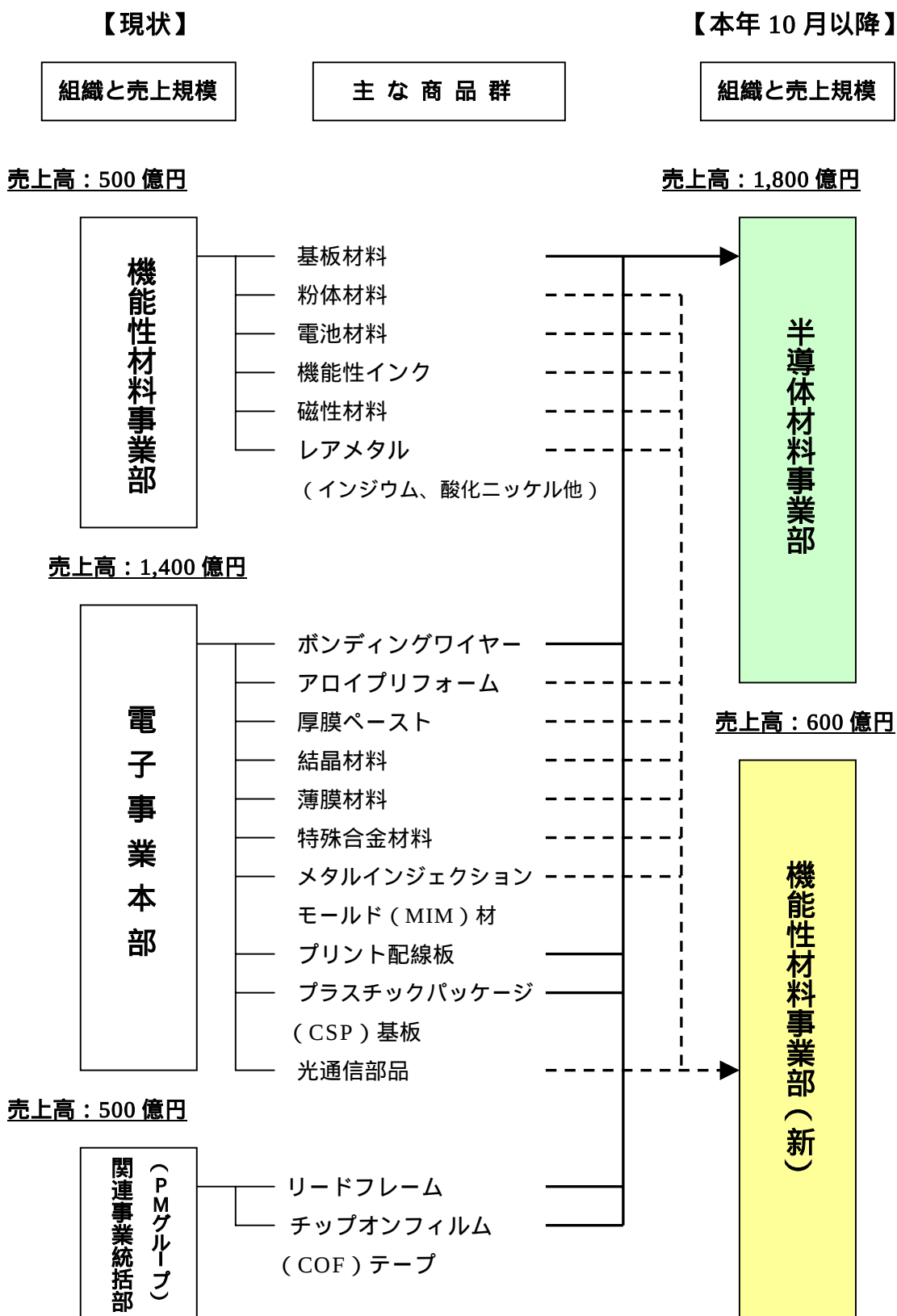


┌───┐ 本件組織改正後の新組織

なお、『関連事業統括部』は所管関係会社の事業部門への移管、『マネジメントサービスセンター』はその機能の経理部および人事部への移管にともない、発展的に組織を解消いたします。

また、『広報 IR 室』および『監査室』は部組織へ変更いたします。

3. 電子・機能性材料事業の新旧組織とその商品群について



【注】売上規模は、いずれも『2006 年中期経営計画』値

4. 電子・機能性材料事業の生産拠点について

新組織	主 な 商 品 群	主 な 生 産 拠 点
半 導 体 材 料 事 業 部	基板材料	別子事業所 磯浦工場 新居浜電子(株) (株)日東社
	チップオンフィルム (COF) テープ	SUMIKO ELECTRONICS TAIWAN (台湾)
	ボンディングワイヤー	大口電子(株) MALAYSIAN ELECTRONICS (マレーシア) Taiwan Sumiko Materials (台湾) 上海住友金属鉱山電子材料有限公司 (中国)
	リードフレーム	大口電子(株) 新居浜電子(株) 住友金属鉱山パッケージマテリアルズ(株) および傘下の海外関係会社
	プリント配線板	(株)伸光製作所
	プラスチックパッケージ (CSP) 基板	(株)伸光製作所
機 能 性 材 料 事 業 部 (新)	粉体材料	別子事業所 磯浦工場
	厚膜ペースト	青梅事業所 上海住友金属電子ペースト有限公司 (中国) 東莞住友金属電子ペースト有限公司 (中国)
	電池材料	別子事業所 磯浦工場
	機能性インク	大口電子(株)
	磁性材料	国富事業所
	アロイプリフォーム	青梅事業所
	結晶材料	青梅事業所 国富事業所
	薄膜材料	青梅事業所
	レアメタル (インジウム、酸化ニッケル他)	播磨事業所、別子事業所 ニッケル工場
	特殊合金材料	相模工場
	メタルインジェクション	相模工場
	モールド (MIM) 材	
	光通信部品	(株)エス・エム・エム プレシジョン

【注】斜字体の生産拠点は関係会社